

株式会社東京精密 2023年度(2024年3月期) 第1四半期 決算説明会

2023年8月2日

2024年3月期 第1四半期決算説明会(Web開催)

当社 出席者：

代表取締役副社長CFO 川村 浩一

経営支援室 IRチームリーダー 高嶋 直樹

◆ **将来の事象に係わる記述に関する注意**

- 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ **表記データ・用語について**

- 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。
- 2022年度より、在外子会社の収益及び費用は、従来の期末レートから期中平均レートにより円換算する方法に変更しております。これに伴い、補足資料の2021年度の数値は、期中平均レートを遡及適用した数値を記載しております。

◆ **監査について**

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前四半期比	前年同期比
受注高	462	340	301	260	295	+14%	-36%
売上高	279	432	320	437	266	-39%	-5%
営業利益 (営業利益率)	57 (20%)	100 (23%)	74 (23%)	114 (26%)	43 (16%)	-63%	-25%
経常利益	65	101	71	116	47	-60%	-28%
当期純利益	48	71	33	84	32	-61%	-33%

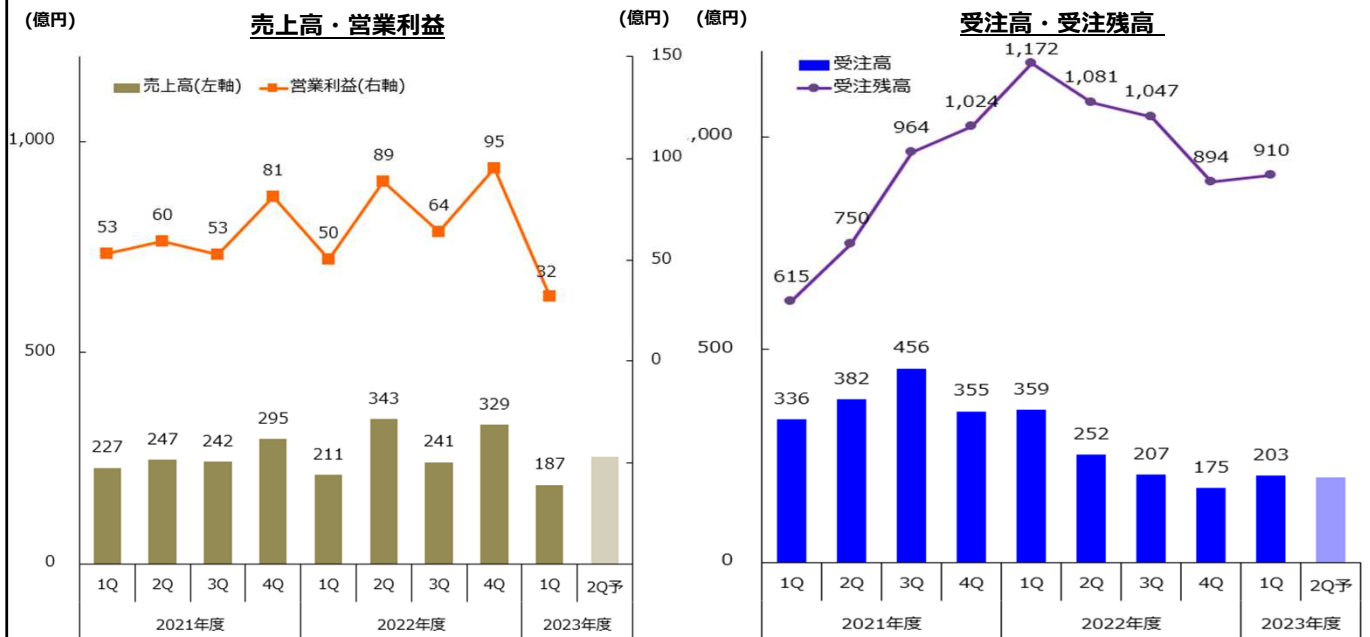
- 半導体中心に減収減益だが ほぼ想定内の着地
- 受注高は前年同期比減少が続くが、前四半期比では増加

- 代表取締役副社長CFOの川村です。日頃大変お世話になっております。
- それでは決算概要を説明いたします。
2023年度 第1四半期の業績は、受注高 295億円、売上高 266億円、
営業利益 43 億円、 経常利益 47 億円となり、
親会社株主に帰属する当期純利益は、32 億円となりました。
営業利益率は16%となりました。
- 減収減益となりましたが、ほぼ 社内計画内での着地となっております。
- 受注高は、前年同期比での減少が続きましたが、
社内計画を若干上振れたほか、前四半期比で増加しました。
- 次に、セグメント別に説明いたします。

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前四半期比	前年同期比
受注高	359	252	207	175	203	+16%	-43%
売上高	211	343	241	329	187	-43%	-11%
営業利益 (営業利益率)	50 (24%)	89 (26%)	64 (27%)	95 (29%)	32 (17%)	-66%	-37%

- 民生向けが全般に軟調が続くも、想定内の売上
- 受注高は 前四半期比で増加

- こちらは、半導体製造装置セグメントの業績です。
- この第1四半期は、
受注高は 203億円、売上高は 187億円、営業利益は 32億円、
営業利益率は 17%でした。
- 民生向けの需要は、この第1四半期も 引き続き軟調に推移しましたが、
概ね 想定内の売上高で着地しました。
- 受注高は、前年同期比での減少が続いていますが、前四半期比では増加となりました。



- 売上高・営業利益：ほぼ想定通り。生産は高水準を維持
- 受注・受注残高：パワー半導体、アナログ半導体、ウェーハ増産等で堅調を維持
想定を上回ったが、民生用途の回復は鈍い

Aug 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

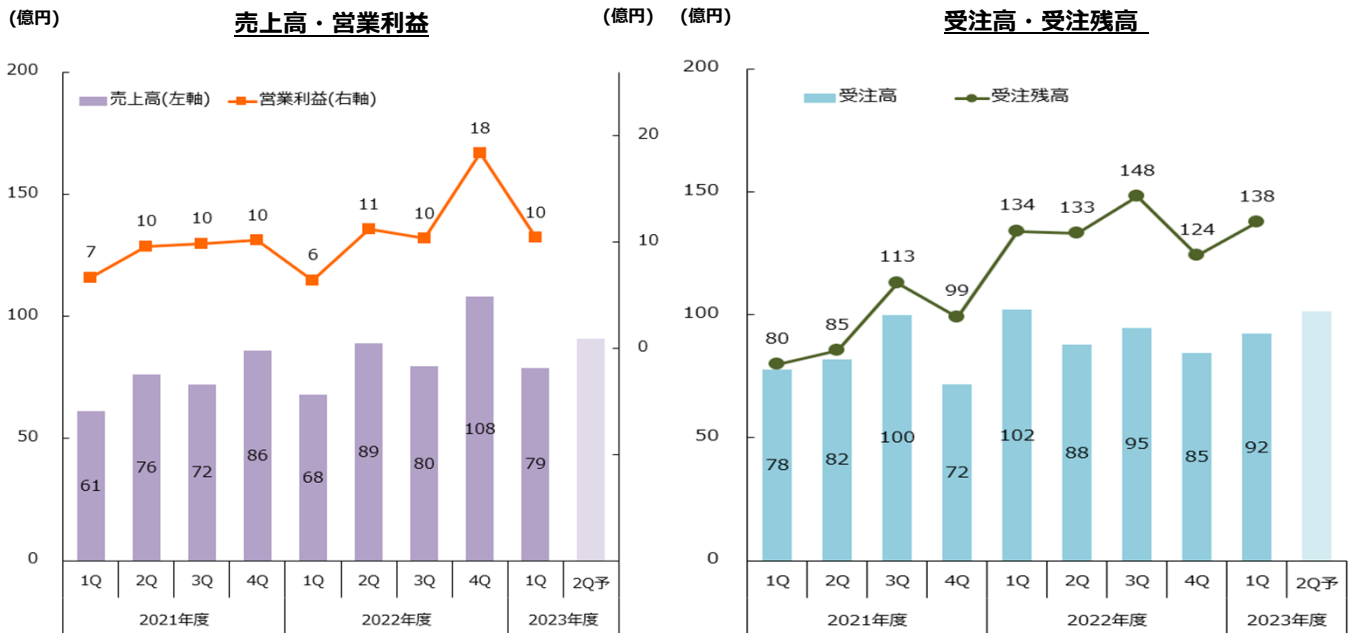
5

- こちらは、半導体の四半期推移グラフです。
- 左側、売上高グラフですが、
この第1四半期の売上高は減少しておりますが、これは、受注済案件の納期が第2四半期の方に多くなっていることもあるからで、この水準はほぼ想定内です。
そのため、生産は高水準を維持しました。
- 右側、受注高グラフですが、
パワー半導体、アナログ半導体、ウェーハ増産用途は、引き続き堅調でした。
その結果、当初 150億円程度と予想していた受注高は、上振れて着地しました。
- しかし、スマホなどの民生用途、OSATからの引合いなどは、引き続き軟調でした。
- 現時点では、第2四半期の受注高は、第1四半期比 横ばいと想定しています。
状況の変化も考えられますので、動向を注視してまいります。

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前四半期比	前年同期比
受注高	102	88	95	85	92	+9%	-10%
売上高	68	89	80	108	79	-27%	+16%
営業利益 (営業利益率)	6 (10%)	11 (13%)	10 (13%)	18 (17%)	10 (13%)	-43%	+62%

- 受注残高の出荷が進み、増収増益の着地
- 受注高は、前四半期比増加するも 前年の水準は下回る

- 続いて、計測機器セグメントの業績です。
- 第1四半期の実績は、
受注高 92億円、売上高 79億円、営業利益 10億円で、
営業利益率は 13%でした。
- 受注済の案件の出荷が 計画通り進み、
売上高・営業利益は、前年同期比で増加しました。
- 受注高は、前年の価格改定の駆け込み需要からの反動もあり、
前年同期比で減少したものの、前四半期比では増加しました。



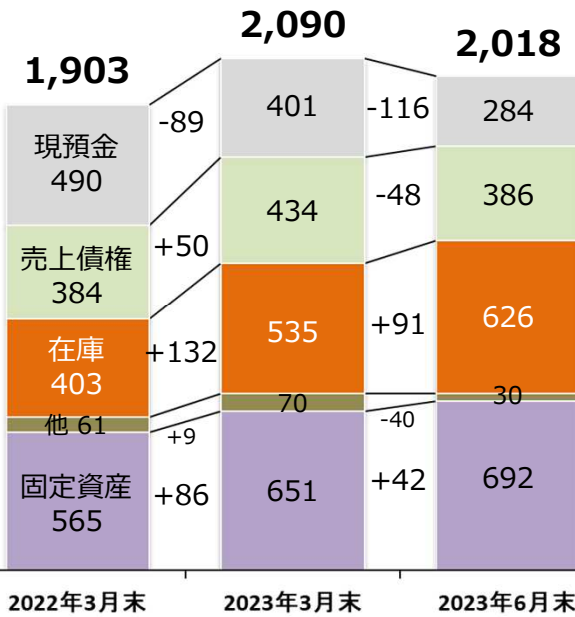
- 売上高・営業利益：前年・前々年同期の水準を上回る
- 受注・受注残高：EV関連案件が増加、一方、工作機械関連、半導体装置関連が弱く 想定を下振れ

- こちらは、計測の四半期推移グラフです。
- 左側、売上高グラフですが、全体として想定通りの水準です。例年、季節性により、第1四半期の業績は相対的に低めですが過去2か年の第1四半期水準を上回っており、回復傾向が続いていると考えております。
- 右側、受注高グラフですが、バッテリー試験システムの需要など、EV関連の引合いが増加しましたが工作機械関連や半導体装置需要など、一部 軟調な分野があり、想定していた 約100億円の水準は下回る結果となりました。また、前年第1四半期は 価格改定前の駆け込み需要があり、前年比はその反動減となりました。
- なお、第2四半期の受注高は、第1四半期比 10%程度の増加を想定しています。

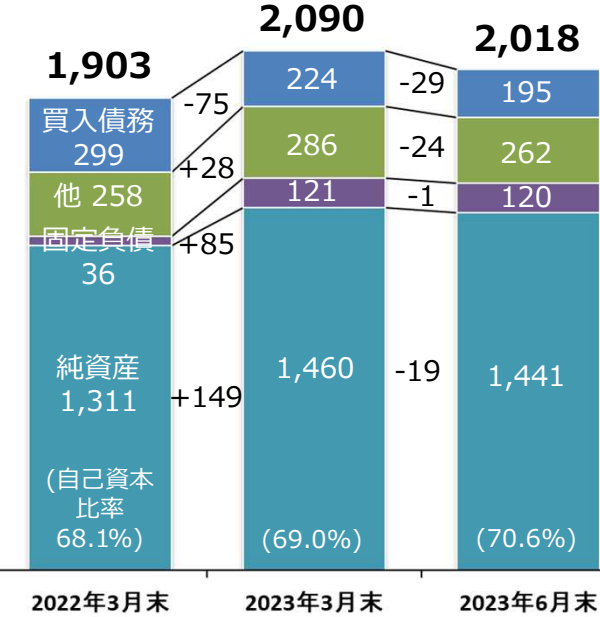
貸借対照表



資産の部(億円)



負債・純資産の部(億円)



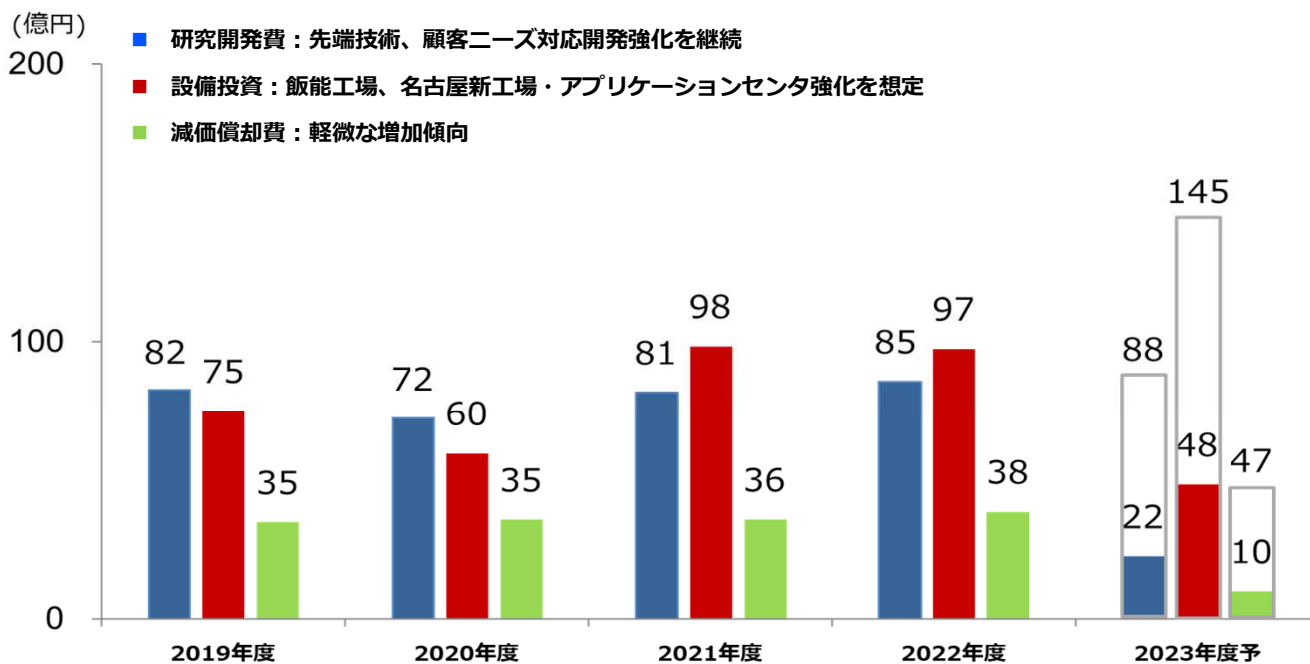
- 資産の部：今後の出荷に向けた積み増し等により 在庫が増加
- 負債・純資産の部：買掛サイト短縮等により 買入債務が減少

Aug 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

8

- こちらは貸借対照表の説明になります。
- 2023年6月末の総資産は、2,018億円となりました。
- 左側、資産の部ですが、工場をフル稼働させて在庫を積み増し、今後の出荷に備えており在庫が3月末対比で増加しました。また、飯能新工場に関連した固定資産が増加しました。
- 右側、負債については、前期後半から買掛金サイトの短縮を進めた結果、流動負債が減少したほか、配当の支払い等により純資産が減少しました。
- 6月末の自己資本比率は70.6%となりました。



➤ 2023年度 研究開発費等の計画に変更なし

- こちらは試験研究費、設備投資、減価償却の第1四半期の実績と今期の計画です。
- 2023年度 通期計画の変更はございません。
- 設備投資について、第1四半期は、飯能工場分が計上されており、今後は、名古屋で検討中の新工場分が、一部計上される予定です。

全体

- 今後の出荷に備え 高水準の生産を維持
- 部材不足は一部を除き 緩和へ
- 半導体の輸出関連規制の動向を注視

半導体

- 民生関連の需要は年度一杯低迷する見通し
- 次のアップターンを見据え、生産キャパシティ拡張、研究開発、アプリケーション強化に取り組む

計測

- 内需は全般に安定
- 自動車向けはNEVの拡大を想定
- 非自動車分野への拡販や、自動化向けソリューション強化を進める

- 次に、2023年度の業績予想についてです。
5月の説明会でお示した、予想の前提をアップデートしたものがこちらとなります。青字が変更点です。
- 中段の半導体の受注の見通しについてですが、
民生品の在庫調整は、期初の想定以上に長期化していると考えています。
期初の段階では、この在庫調整がひと段落することで、
下期以降、当社の受注高が緩やかに回復する前提でしたが、
現時点では、年度一杯 停滞すると見えています。
- 一方で、パワー半導体、ウェーハ増産用途など、
現在も需要が強い業界の引合いは引き続き継続すると予想するほか、
ハイブリッドボンディングなどの研究開発案件は 下期以降 活発になると想定します。
- これらの案件に対応するためにも、高水準の生産を進める所存です。

2023年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2022年度			2023年度予			
	上期	下期	通期	上期予	下期予	通期予	前期比
売上高	711	757	1,468	610	680	1,290	-12%
営業利益 (営業利益率)	157 (22%)	188 (25%)	345 (24%)	110 (18%)	130 (19%)	240 (19%)	-30%
経常利益	166	187	353	110	130	240	-32%
当期純利益	119	117	236	80	90	170	-28%
1株配当			235円			170円	-65円

セグメント別業績予想

(半導体)	受注高	612	382	994				
	売上高	554	570	1,124	440	500	940	-16%
(計測)	受注高	190	179	370				
	売上高	157	188	344	170	180	350	+2%

- 2023年5月12日に公表した通期業績予想・配当予想の修正なし
- 前提為替レートも据え置き (米ドル：130円、1ドル1円の円高で△1.2億円程度の影響)

Aug 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

11

- 以上の前提を踏まえたうえで、2023年度の業績予想は、5月にお示しした予想を据え置くことといたしました。
- この第2四半期は、第1四半期に対して 売上・利益ともに増加を見込むほか下期も、上期比で 増収増益となる想定です。
- なお、為替前提は円ドル130円を据え置いております。
- 私からの説明は以上となります。ありがとうございました。



IR情報



<https://ir.accretech.jp/ja/index.html>

統合報告書



https://ir.accretech.jp/ja/integrated_report.html

サステナビリティ情報



<https://www.accretech.jp/sustainability/index.html>

補足資料

Supplementary Data

セグメント別業績推移 Segment Information



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Orders 受注額	半導体 SPE	57,709	93,181	152,896	99,366	35,918	25,246	20,663	17,537	20,345		
	計測 Metr.	29,866	23,878	33,159	36,960	10,246	8,788	9,472	8,452	9,225		
	合計 Total	87,576	117,060	186,056	136,326	46,165	34,034	30,136	25,990	29,571		
Backlog 受注残高	半導体 SPE	29,182	50,619	102,370	89,371	117,153	108,134	104,714	89,371	90,993		
	計測 Metr.	7,782	6,301	9,904	12,428	13,367	13,263	14,782	12,428	13,758		
	合計 Total	36,965	56,920	112,274	101,799	130,520	121,398	119,496	101,799	104,752		
Sales 売上	半導体 SPE	56,198	71,745	101,145	112,365	21,135	34,264	24,084	32,880	18,722		
	計測 Metr.	31,728	25,359	29,556	34,436	6,783	8,892	7,954	10,806	7,895		
	合計 Total	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618		
OP 営業利益	半導体 SPE	7,915	13,565	24,698	29,866	5,049	8,874	6,416	9,526	3,208		
	計測 Metr.	4,366	1,996	3,628	4,628	641	1,120	1,031	1,834	1,042		
	合計 Total	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250		
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	14.1%	18.9%	24.4%	26.6%	23.9%	25.9%	26.6%	29.0%	17.1%		
	計測 Metr.	13.8%	7.9%	12.3%	13.4%	9.5%	12.6%	13.0%	17.0%	13.2%		
	合計 Total	14.0%	16.0%	21.7%	23.5%	20.4%	23.2%	23.2%	26.0%	16.0%		

損益計算書 Statements of Income



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
売上高 Net Sales	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618				
売上原価 Cost of goods sold	53,452	60,190	77,694	84,967	15,940	25,783	18,220	25,022	15,415				
売上総利益 Gross Profit on Sales	34,474	36,914	53,008	61,834	11,978	17,372	13,817	18,664	11,203				
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	22,192	21,351	24,681	27,339	6,287	7,378	6,369	7,303	6,952				
営業利益 Operating profit	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250				
営業外収益 Non-operating income	255	540	987	965	824	96	-229	274	563				
営業外費用 Non-operating expenses	177	235	153	162	18	25	111	7	103				
経常利益 Recurring Profit	12,360	15,867	29,160	35,297	6,496	10,065	7,107	11,628	4,710				
特別利益 Extraordinary gains	57	1,354	390	103	5	58	12	25	26				
特別損失 Extraordinary losses	1,712	1,074	34	2,099	-	-	1,751	347	-				
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	10,705	16,147	29,516	33,301	6,502	10,124	5,368	11,306	4,736				
法人税等合計 Total Income tax and others	3,598	3,978	8,132	9,607	1,660	3,019	2,011	2,916	1,456				
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	7,156	12,175	21,326	23,630	4,812	7,096	3,338	8,383	3,245				
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	171.89	293.83	522.52	581.33	118.38	174.47	82.05	206.60	80.63				
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	170.72	291.43	517.51	575.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aug 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

15

貸借対照表 Balance Sheet



(百万円) (Million Yen)		2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期(1Q末) FY2024/3 (1Q)
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	43,657	49,033	40,080	28,433
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	30,946	38,367	43,403	38,557
	在庫 Inventories	32,886	40,325	53,482	62,544
	その他 Others	4,025	6,103	7,005	3,017
	合計 Total	111,516	133,829	143,972	132,562
固定資産合計 Total Fixed Assets		50,039	56,457	65,060	69,213
総資産 Total Assets		161,556	190,287	209,032	201,775
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	23,062	29,876	22,359	19,464
	その他 Others	16,233	25,765	28,588	26,216
	合計 Total	39,296	55,641	50,947	45,681
固定負債合計 Total long-term liabilities		5,482	3,564	12,057	12,013
負債合計 Total Liabilities		44,778	59,206	63,004	57,695
純資産合計 Total Net Assets		116,777	131,081	146,028	144,080
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		161,556	190,287	209,032	201,775
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		7,581	5,497	14,191	13,143
自己資本比率 Equity Ratio(%)		71.4%	68.1%	69.0%	70.6%
自己資本利益率 ROE(%)		10.9%	17.4%	17.3%	-

※1: 電子記録債権、契約資産を含む

Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む

Incl. Electronically recorded obligations-operating

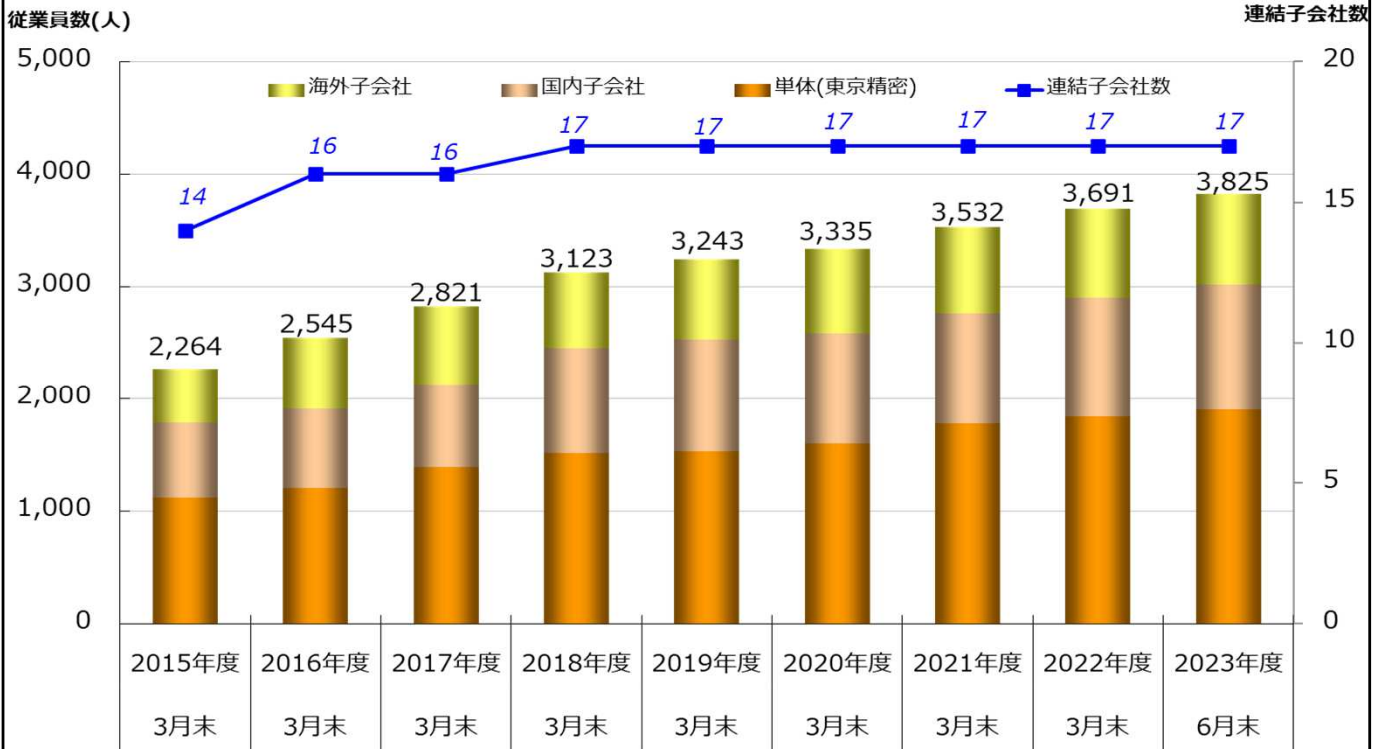
各種費用, キャッシュフロー Expenses and Cash Flows



(百万円) (Million Yen)	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期(1Q) FY2024/3(1Q)
試験研究費 R&D expenses	7,193	8,146	8,542	2,225
設備投資 Capex	5,950	9,793	9,725	4,817
減価償却費 (のれん除く) Depreciation (excl. Amortization)	3,516	3,551	3,832	957

(百万円) (Million Yen)	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	22,062	23,837	1,000
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-5,191	-8,990	-8,421
フリーキャッシュフロー Free cash flows	16,871	14,846	-7,421
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-8,282	-10,346	-2,174
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	429	882	625
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	43,624	49,006	40,036

従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算